

深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于签署合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1、本协议所涉及的投资项目尚未完成可行性研究，尚需上报政府相关主管部门进行立项审批或备案、环境影响评价审批等程序，相关项目能否获得批准、何时获得批准、投资所涉及到的规模、建设周期等包括但不限于此的各事项均存在不确定性。公司将严格按照相关规定，对该合作事宜的进展情况进行及时的披露，并根据项目投资规模提交董事会或股东大会审议，履行相应的审批程序。

2、由于不可抗力或上级政策的调整，致使本协议无法履行，双方可以协商签订补充协议或解除本协议。

3、本协议所涉及的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、概述

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“乙方”）于2017年8月9日与江苏省常州市金坛华罗庚科技产业园管理委员会（以下简称“金坛管委会”或者“甲方”）签订了《合作协议》（以下简称“协议”）。公司拟在金坛华罗庚科技产业园投资建设“飞荣达科技园”，并通过发起设立的全资子公司“飞荣达科技（江苏）有限公司”（暂定名，以企业登记核准名称为准）具体实施“飞荣达高导材料项目”，该项目主要从事电磁屏蔽材料、导热材料、吸波材料等高导材料及其器件的研发、生产和销售等业务。

金坛华罗庚科技产业园位于常州市金坛经济开发区内，规划总占地面积15.8平方公里。该产业园以新材料和智能装备制造为主要产业发展方向，积极推进“产、

学、研、金”合作一体化，建立科技创新公共服务平台、人才引进培育基地和科技金融发展中心，使之成为高标准科技企业孵化器、现代服务业集聚区。

二、合作协议的主要内容

1、项目实施公司设立：自协议签订生效后的一个月内，飞荣达在华科园内发起设立全资子公司—飞荣达科技（江苏）有限公司（暂定名，以企业登记核准名称为准），注册资本1亿元，负责飞荣达高导材料项目的实施。

2、用地面积：项目规划占地面积约520亩，四至范围为：东至云湖路、北至金龙大道、西至水北路、南至华业路，容积率不低于1.2、建筑密度不低于45%。

3、土地出让：甲方将以“招拍挂”的形式向乙方出让土地约520亩（以实际出让的土地面积为准），最终土地成交金额以挂牌成交价为准，使用年限为国家规定的年限，土地性质为工业用地。

待后续设立的全资子公司竞得土地使用权后，公司将以公告的形式进一步披露土地具体地理位置及其他相关信息。

三、本次合作协议的目的和对公司的影响

本次合作加大了公司对长三角地区的市场开拓力度，有效集约整合销售资源，增强公司研发、生产及销售流程的运营管理效率，也有助于提升公司的综合竞争能力和盈利能力，为实现公司长期、持续、稳定发展打下坚实的基础。

该项目建成后有助于公司更好地利用长三角优秀的行业研发、技术资源和优越的地理位置，进一步推动公司生产基地的区域合理布局。

四、存在的风险

（1）根据项目后续的投资规模及进展，公司将按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定提交董事会或股东大会审议，并根据该事项的进展或变化情况及时履行相关的披露义务。项目能否获得批准、何时获得批准以及能否顺利实施存在不确定性。

（2）本协议所述的拟投资项目尚未进行立项审批、环境影响评价审批，该项目用地尚未进入出让程序，该项目涉及的用地面积、土地款、项目计划进程、公司能否最终竞买取得土地均存在不确定性。

(3) 本次签订的合作协议涉及的项目实施周期、具体实施进度与执行情况存在不确定性，尚需合作双方进一步沟通和落实。

综上所述，本次签订的《合作协议》具有一定不确定性和风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司与金坛华罗庚科技产业园管理委员会签订的《合作协议》。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2017年8月9日